



Title of Change:	Alternate LED manufacturing site, alternate LED die source and change leadframe plating from pure Tin (Sn) to PPF (pre-plated frame).
Proposed First Ship date:	15 Oct 2021 or earlier if approved by customer
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Esther.Lau@onsemi.com
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or PCN.samples@onsemi.com . Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or ChangKit.Mok@onsemi.com
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Datecode
Change Category:	Alternate LED manufacturing site, alternate LED die source
Change Sub-Category(s):	Material Change

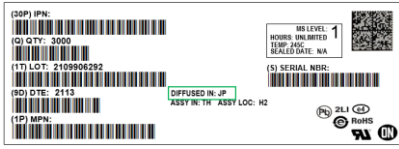

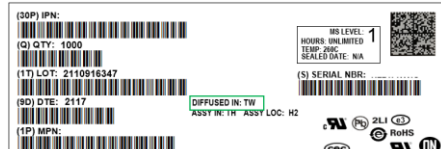
Sites Affected:

ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites
None	External Subcon

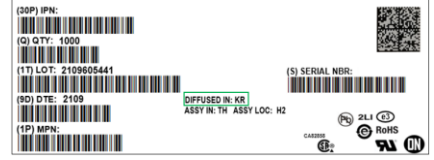
Description of change:

1. To introduce an alternate LED die source from the current supplier from a different wafer manufacturing site in Japan (JP) and another die source from supplier in Taiwan (TW) and Korea (KR). All the part numbers listed in this PCN is affected by this change.

Change table summary:

Item	Before Change (Change From)	After Change (Change To) Add as Alternate I	After Change (Change To) Add as Alternate II
1.1	<p>LED die source from Supplier A at wafer fab site, X in Japan.</p> <p>MPN Label: Diffused in: JP</p> 	<p>LED die source from Supplier A at wafer fab site, Y in Japan.</p> <p>MPN Label: Diffused in: JP</p> 	<p>LED die source from Supplier B in Taiwan or Supplier C in Korea.</p> <p>MPN Label: Diffused in: TW</p> 

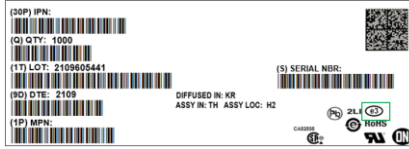



			<p>Diffused in: KR</p> 
1.2	<p>Supplier A: LED size: 10 x 10 mils Bonding pad: 120um</p> <p>OR</p> <p>Supplier A: LED size: 11 x 11 mils Bonding pad: 120um</p>	<p>Supplier A: LED size: 10 x 10 mils Bonding pad: 120um</p>	<p>Supplier B: LED size: 9 x 9 mils Bonding pad: 140um</p> <p>OR</p> <p>Supplier C: LED size: 9.8 x 9.8mils Bonding pad: 120um</p>

2. Change leadframe plating from pure Tin (Sn) to PPF (pre-plated frame) leadframe.

Not all the affected part numbers listed in the PCN are affected by this change. Refer Table 2 for affected part numbers.

Change table summary:

Item	Before Change (Change From)	After Change (Change To)
2.1	Leadframe base material: C194, Cu DAP with Ag plating. Lead finish: Pure Tin (Sn)	Leadframe base material: C194, Cu DAP with NiPdAu Lead finish: NiPdAu
2.2	Lead Finish Category (eCAT): e3 	Lead Finish Category (eCAT): e4 

Reason for change:

The qualification of the alternate manufacturing site for existing die, alternate LED die source and qualification of PPF leadframe is for flexible manufacturing planning and continuity of supply. The qualification of PPF leadframe is also to standardize the bill of material at assembly site.

This change will have no impact on quality, reliability, electrical and the product will remain fully compliant. There will be no datasheet changes. Product incorporating both changes will be shipped interchangeably with existing unchanged products.

**Table 1:** Affected part list for manufacturing site and die source change described in change item 1.

6N137	HCPL3700SVM	FOD8343	H11F3VM	HCPL0701	HCPL2630SM
6N137SD	HCPL3700VM	FOD8343R2	H11N1M	HCPL0701R2	HCPL2630SV
FOD050L	FOD8173	FOD8343T	H11N1SM	HCPL0701R2V	HCPL2630V
FOD050LR2	FOD8163	FOD8343TR2	H11N1SR2M	HCPL0701V	HCPL2631
FOD053L	FOD8163R2	FODM452	H11N1SR2VM	HCPL0731	HCPL2631M
FOD053LR2	FOD8163T	FODM452R2	H11N1SVM	HCPL0731R2	HCPL2631S
FOD060L	FOD8163TR2	FODM452R2V	H11N1TVM	HCPL2530M	HCPL2631SD
FOD060LR2	FOD8314	FODM452V	H11N1VM	HCPL2530SDM	HCPL2631SDM
FOD073L	FOD8314R2	FODM453	HCPL0453	HCPL2530SM	HCPL2631SDV
FOD073LR2	FOD8314T	FODM453R2	HCPL0453R2	HCPL2531M	HCPL2631SM
FOD3120	FOD8314TR2	FODM453R2V	HCPL0500	HCPL2531SDM	HCPL2631SV
FOD3120S	FOD8173T	FODM453V	HCPL0500R2	HCPL2531SDVM	HCPL2631V
FOD3120SD	FOD3125	FODM611	HCPL0500R2V	HCPL2531SM	HCPL2631WV
FOD3120SDV	FOD3125S	FODM611R2	HCPL0500V	HCPL2531SVM	HCPL2731M
FOD3120SV	FOD3125SD	FODM8061	HCPL0501	HCPL2531TSR2VM	HCPL2731SDM
FOD3120TSR2	FOD8342	FODM8061R2	HCPL0501R2	HCPL2531TSVM	HCPL2731SM
FOD3120TSR2V	FOD8342R2	FODM8061R2V	HCPL0501R2V	HCPL2531TVM	HCPL3700M
FOD3120TSV	FOD8342T	FODM8061V	HCPL0501V	HCPL2531VM	MCT5210M
FOD3120TV	FOD8342TR2	H11AG1M	HCPL0531	HCPL2601	MCT5210SM
FOD3120V	FOD8342TR2V	H11AG1SM	HCPL0531R2	HCPL2601S	MCT5211M
FOD3150	FOD8342V	H11AG1SR2M	HCPL0534	HCPL2601SD	MCT5211SR2M
FOD3150A	FOD8343TR2V	H11AG1TVM	HCPL0534R2	HCPL2601V	MCT5211TVM
FOD3150AS	FOD8342R2V	H11AG1VM	HCPL0600	HCPL2601WV	FOD8314TR2V
FOD3150ASD	FOD8342TV	H11F1M	HCPL0600R2	HCPL2611	HCPL2630SDVM
FOD3150ASDV	FOD8342ATR2	H11F1SM	HCPL0601	HCPL2611S	HCPL2630SVM
FOD3150S	FOD8342ATR2V	H11F1SR2M	HCPL0601R2	HCPL2611SV	FOD8163R2V
FOD3150SD	FOD8342ATV	H11F1TVM	HCPL0601R2V	HCPL2611V	FOD8163TR2V
FOD3150SDV	FOD8342AR2	H11F1VM	HCPL0601V	HCPL2630	FOD8163V
FOD3150SV	FOD8342AR2V	H11F3M	HCPL0611	HCPL2630M	FOD8173TR2
FOD3150TSR2V	FOD8342AT	H11F3SM	HCPL0611R2	HCPL2630S	
FOD3150TSV	FOD8342A	H11F3SR2M	HCPL0700	HCPL2630SD	
FOD3150TV	FOD8343TV	H11F3SR2VM	HCPL0700R2	HCPL2630SDM	
FOD3150V	FOD8342AV	H11F3SVM	HCPL0700V	HCPL2630SDV	

**Table 2:** Affected part list for both changes described in change item 1 and item 2.

6N135M	6N136TSVM	6N138SDM	FOD260LSV	FOD3182TSR2	FOD3184V
6N135SDM	6N136TVM	6N138SM	FOD3180	FOD3182TSR2V	FOD3184TSR2
6N135SDVM	6N136VM	6N139M	FOD3180S	FOD3182TSV	HCPL2611M
6N135SM	6N137M	6N139SDM	FOD3180SD	FOD3182TV	HCPL4503M
6N135SVM	6N137SDM	6N139SDVM	FOD3180SDV	FOD3182V	HCPL4503SDM
6N135TVM	6N137SDVM	6N139SM	FOD3180SV	FOD3184	HCPL4503SDVM
6N135VM	6N137SM	6N139SVM	FOD3180TSV	FOD3184S	HCPL4503SM
6N136M	6N137SVM	6N139TVM	FOD3180TV	FOD3184SD	HCPL4503SVM
6N136SDM	6N137TSR2VM	6N139VM	FOD3182	FOD3184SDV	HCPL4503TSR2VM
6N136SDVM	6N137TSVM	FOD260L	FOD3182S	FOD3184SV	HCPL4503TSVM
6N136SM	6N137TVM	FOD260LS	FOD3182SD	FOD3184TSR2V	HCPL2611SDM
6N136SVM	6N137VM	FOD260LSD	FOD3182SDV	FOD3184TSV	HCPL2611SM
6N136TSR2VM	6N138M	FOD260LSDV	FOD3182SV	FOD3184TV	

Reliability Data Summary:

QV DEVICE NAME:FODM8801A

RMS: 2010000499

PACKAGE: MFP-4

Test	Specification	Condition	Interval	Results
ELFR	JESD22-A108	Ta=125°C, VDC=5V@20mA /VCE=5V@30mA bias	48 hours	0/2400
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, VDC=5V@20mA /VCE=5V@30mA bias	1008 hours	0/240
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hours	0/240
TC + PC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	1000 cycles	0/240
THB + PC	JESD22-A101	85°C, 85% RH, VDC=5V@5mA / VCE=5V@5mA bias	1008 hrs	0/240
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 245°C	-	0/160

QV DEVICE NAME: 6N136M

RMS: 2101001943

PACKAGE: PDIP 8 (SMT)

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, VDC=5V@20mA /VCE=5V@6mA bias	1008 hours	0/240
HTSL	JESD22-A103	Ta= 125°C	1008 hours	0/240
TC + PC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	1000 cycles	0/240
THB + PC	JESD22-A101	85°C, 85% RH, VDC=5V@5mA / VCE=5V@5mA bias	1008 hrs	0/240
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	-	0/160



QV DEVICE NAME: MCT5211M

RMS: 2010000451 / 2102002254

PACKAGE: PDIP 6 (SMT)

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, VDC=5V@20mA /VCE=5V@30mA bias	1008 hours	0/240
ELFR	JESD22-A108	Ta=125°C, VDC=5V@20mA /VCE=5V@30mA bias	48 hours	0/2400
HTSL	JESD22-A103	Ta= 125°C	1008 hours	0/240
TC + PC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	1000 cycles	0/240
THB + PC	JESD22-A101	85°C, 85% RH, VDC=5V@5mA / VCE=5V@5mA bias	1008 hrs	0/240
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	-	0/160

QV DEVICE NAME: FODM8801A

RMS: 2011000949

PACKAGE: MFP-4

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, VDC=5V@20mA /VCE=5V@30mA bias	1008 hours	0/240
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hours	0/240
TC + PC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	1000 cycles	0/240
THB + PC	JESD22-A101	85°C, 85% RH, VDC=5V@5mA / VCE=5V@5mA bias	1008 hrs	0/240
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 245°C	-	0/160

Electrical Characteristics Summary:

Electrical characteristics are not impacted

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

To view attached Parts Lists:

1. Download pdf copy of the PCN to your computer
2. Open the downloaded pdf copy of the PCN
3. Click on the paper clip icon available on the menu provided in the left/bottom portion of the screen to reveal the Attachment field
4. Then click on the attached file

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN24095X

発行日: 15 Jul 2021

変更件名:	代替 LED 製造拠点、代替 LED ダイ供給源、およびリードフレームメッキの純粋スズ (Sn) から PPF (メッキ済みフレーム) への変更。
初回出荷予定日:	2021 年 10 月 15 日 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前。
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または Esther.Lau@onsemi.com > にお問い合わせください。
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回 PCN または最終 PCN の最初の通知の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または ChangKit.Mok@onsemi.com > にお問い合わせください。
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、 PCN.Support@onsemi.com > 宛てにお願いします。
変更部品の識別:	デートコード
変更カテゴリ:	代替 LED 製造拠点、代替 LED ダイ供給源
変更サブカテゴリ:	材料の変更
影響を受ける拠点:	
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:
無し	外部サブコン

説明および目的:

1. 現サプライヤの日本 (JP) の異なるウェハ製造拠点からの代替 LED ダイ供給、および台湾 (TW) と韓国 (KR) のサプライヤから他のダイ供給を導入することが目的です。この変更により本 PCN に記載されたすべての部品番号が影響を受けます。

変更表要約:

項目	変更前	変更後 代替 I として追加	変更後 代替 II として追加
1.1	<p>サプライヤ A の日本のウェハ製造拠点 X からの LED ダイ供給。</p> <p>MPN ラベル: Diffused in: JP</p>	<p>サプライヤ A の日本のウェハ製造拠点 Y からの LED ダイ供給。</p> <p>MPN ラベル: Diffused in: JP</p>	<p>台湾のサプライヤ B または韓国のサプライヤ C からの LED ダイ供給</p> <p>MPN ラベル: Diffused in: TW</p>



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN24095X

発行日: 15 Jul 2021

			Diffused in: KR
1.2	サプライヤ A: LED サイズ: 10 x 10 mil ボンディング・パッド: 120 um または サプライヤ A: LED サイズ: 11 x 11 mil ボンディング・パッド: 120 um	サプライヤ A: LED サイズ: 10 x 10 mil ボンディング・パッド: 120 um	サプライヤ B: LED サイズ: 9 x 9 mil ボンディング・パッド: 140 um または サプライヤ C: LED サイズ: 9.8 x 9.8 mil ボンディング・パッド: 120 um

2.リードフレームメッキの純粋スズ (Sn) から PPF (メッキ済みフレーム) への変更。

この変更により本 PCN に列記された影響を受ける部品番号のすべてが影響を受けるわけではありません。影響を受ける部品番号は表 2 を参照してください。

変更表要約:

項目	変更前	変更後
2.1	リードフレーム基材: C194, Cu DAP with Ag plating. Lead finish: Pure Tin (Sn)	リードフレーム基材: C194, Cu DAP with NiPdAu Lead finish: NiPdAu
2.2	Lead Finish Category (eCAT): e3 	Lead Finish Category (eCAT): e4

変更の理由:

既存のダイの代替製造拠点の認証、代替 LED ダイ供給、および PPF リードフレームの認証は柔軟な製造計画と供給の継続性のためです。PPF リードフレームの認定は組み立て拠点の部品表の標準化のためです。

この変更による製品の品質、信頼性、電気的性能、製品への影響はありません。データシートの変更はありません。両方の変更を取り入れている製品は既存の変更がない製品と区別なく出荷されます。



表 1: 変更項目 1 に記載された製造拠点およびダイ供給の変更に影響を受けるリスト

6N137	HCPL3700SVM	FOD8343	H11F3VM	HCPL0701	HCPL2630SM
6N137SD	HCPL3700VM	FOD8343R2	H11N1M	HCPL0701R2	HCPL2630SV
FOD050L	FOD8173	FOD8343T	H11N1SM	HCPL0701R2V	HCPL2630V
FOD050LR2	FOD8163	FOD8343TR2	H11N1SR2M	HCPL0701V	HCPL2631
FOD053L	FOD8163R2	FODM452	H11N1SR2VM	HCPL0731	HCPL2631M
FOD053LR2	FOD8163T	FODM452R2	H11N1SVM	HCPL0731R2	HCPL2631S
FOD060L	FOD8163TR2	FODM452R2V	H11N1TVM	HCPL2530M	HCPL2631SD
FOD060LR2	FOD8314	FODM452V	H11N1VM	HCPL2530SDM	HCPL2631SDM
FOD073L	FOD8314R2	FODM453	HCPL0453	HCPL2530SM	HCPL2631SDV
FOD073LR2	FOD8314T	FODM453R2	HCPL0453R2	HCPL2531M	HCPL2631SM
FOD3120	FOD8314TR2	FODM453R2V	HCPL0500	HCPL2531SDM	HCPL2631SV
FOD3120S	FOD8173T	FODM453V	HCPL0500R2	HCPL2531SDVM	HCPL2631V
FOD3120SD	FOD3125	FODM611	HCPL0500R2V	HCPL2531SM	HCPL2631WV
FOD3120SDV	FOD3125S	FODM611R2	HCPL0500V	HCPL2531SVM	HCPL2731M
FOD3120SV	FOD3125SD	FODM8061	HCPL0501	HCPL2531TSR2VM	HCPL2731SDM
FOD3120TSR2	FOD8342	FODM8061R2	HCPL0501R2	HCPL2531TSVM	HCPL2731SM
FOD3120TSR2V	FOD8342R2	FODM8061R2V	HCPL0501R2V	HCPL2531TVM	HCPL3700M
FOD3120TSV	FOD8342T	FODM8061V	HCPL0501V	HCPL2531VM	MCT5210M
FOD3120TV	FOD8342TR2	H11AG1M	HCPL0531	HCPL2601	MCT5210SM
FOD3120V	FOD8342TR2V	H11AG1SM	HCPL0531R2	HCPL2601S	MCT5211M
FOD3150	FOD8342V	H11AG1SR2M	HCPL0534	HCPL2601SD	MCT5211SR2M
FOD3150A	FOD8343TR2V	H11AG1TVM	HCPL0534R2	HCPL2601V	MCT5211TVM
FOD3150AS	FOD8342R2V	H11AG1VM	HCPL0600	HCPL2601WV	FOD8314TR2V
FOD3150ASD	FOD8342TV	H11F1M	HCPL0600R2	HCPL2611	HCPL2630SDVM
FOD3150ASDV	FOD8342ATR2	H11F1SM	HCPL0601	HCPL2611S	HCPL2630SVM
FOD3150S	FOD8342ATR2V	H11F1SR2M	HCPL0601R2	HCPL2611SV	FOD8163R2V
FOD3150SD	FOD8342ATV	H11F1TVM	HCPL0601R2V	HCPL2611V	FOD8163TR2V
FOD3150SDV	FOD8342AR2	H11F1VM	HCPL0601V	HCPL2630	FOD8163V
FOD3150SV	FOD8342AR2V	H11F3M	HCPL0611	HCPL2630M	FOD8173TR2
FOD3150TSR2V	FOD8342AT	H11F3SM	HCPL0611R2	HCPL2630S	
FOD3150TSV	FOD8342A	H11F3SR2M	HCPL0700	HCPL2630SD	
FOD3150TV	FOD8343TV	H11F3SR2VM	HCPL0700R2	HCPL2630SDM	
FOD3150V	FOD8342AV	H11F3SVM	HCPL0700V	HCPL2630SDV	



表 2: 変更項目 1 と項目 2 に記載された両変更に影響を受ける部品リスト

6N135M	6N136TSVM	6N138SDM	FOD260LSV	FOD3182TSR2	FOD3184V
6N135SDM	6N136TVM	6N138SM	FOD3180	FOD3182TSR2V	FOD3184TSR2
6N135SDVM	6N136VM	6N139M	FOD3180S	FOD3182TSV	HCPL2611M
6N135SM	6N137M	6N139SDM	FOD3180SD	FOD3182TV	HCPL4503M
6N135SVM	6N137SDM	6N139SDVM	FOD3180SDV	FOD3182V	HCPL4503SDM
6N135TVM	6N137SDVM	6N139SM	FOD3180SV	FOD3184	HCPL4503SDVM
6N135VM	6N137SM	6N139SVM	FOD3180TSV	FOD3184S	HCPL4503SM
6N136M	6N137SVM	6N139TVM	FOD3180TV	FOD3184SD	HCPL4503SVM
6N136SDM	6N137TSR2VM	6N139VM	FOD3182	FOD3184SDV	HCPL4503TSR2VM
6N136SDVM	6N137TSVM	FOD260L	FOD3182S	FOD3184SV	HCPL4503TSVM
6N136SM	6N137TVM	FOD260LS	FOD3182SD	FOD3184TSR2V	HCPL2611SDM
6N136SVM	6N137VM	FOD260LSD	FOD3182SDV	FOD3184TSV	HCPL2611SM
6N136TSR2VM	6N138M	FOD260LSDV	FOD3182SV	FOD3184TV	

信頼性データの要約:

デバイス名: FODM8801A

RMS: 2010000499

パッケージ: MFP-4

テスト	仕様	条件	間隔	結果
ELFR	JESD22-A108	Ta=125°C, VDC=5V@20mA / VCE=5V@30mA bias	48 hours	0/2400
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, VDC=5V@20mA / VCE=5V@30mA bias	1008 hours	0/240
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hours	0/240
TC + PC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	1000 cycles	0/240
THB + PC	JESD22-A101	85°C, 85% RH, VDC=5V@5mA / VCE=5V@5mA bias	1008 hrs	0/240
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 245°C	-	0/160

デバイス名: 6N136M

RMS: 2101001943

パッケージ: PDIP 8 (SMT)

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, VDC=5V@20mA / VCE=5V@6mA bias	1008 hours	0/240
HTSL	JESD22-A103	Ta= 125°C	1008 hours	0/240
TC + PC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	1000 cycles	0/240
THB + PC	JESD22-A101	85°C, 85% RH, VDC=5V@5mA / VCE=5V@5mA bias	1008 hrs	0/240
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	-	0/160



デバイス名: MCT5211M
 RMS: 2010000451 / 2102002254
 パッケージ: PDIP 6 (SMT)

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, VDC=5V@20mA / VCE=5V@30mA bias	1008 hours	0/240
ELFR	JESD22-A108	Ta=125°C, VDC=5V@20mA / VCE=5V@30mA bias	48 hours	0/2400
HTSL	JESD22-A103	Ta= 125°C	1008 hours	0/240
TC + PC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	1000 cycles	0/240
THB + PC	JESD22-A101	85°C, 85% RH, VDC=5V@5mA / VCE=5V@5mA bias	1008 hrs	0/240
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260°C	-	0/160

デバイス名: FODM8801A
 RMS: 2011000949
 パッケージ: MFP-4

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTOL	JESD22-A108	Ta=125°C, VDC=5V@20mA / VCE=5V@30mA bias	1008 hours	0/240
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hours	0/240
TC + PC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +125°C	1000 cycles	0/240
THB + PC	JESD22-A101	85°C, 85% RH, VDC=5V@5mA / VCE=5V@5mA bias	1008 hrs	0/240
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 245°C	-	0/160

電気的特性の要約:

電気的特性への影響はありません。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

添付された部品リストの表示:

1. ご使用のコンピューターに PDF 版の PCN をダウンロードします。
2. ダウンロードした PDF 版の PCN を開きます。
3. 添付欄を見るには、画面左 / 下部分のメニュー上にあるクリップアイコンをクリックしてください。
4. 添付ファイルをクリックします